证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-007

芯联集成电路制造股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-594,893,008.06元，其中母公司净利润为1,040,738,398.76元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74元，母公司累计未分配利润为848,630,914.20元。经董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度净利润为负的情况，2025年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-006

芯联集成电路制造股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“芯联集成”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本次发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）25,471.45万元后，实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。本次发行募集资金已于2023年5月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号）。

2023年6月8日，保荐人国泰海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用（不含增值税）3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构（主承销商）已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399号）。

全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年科创板首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月5日 2023年6月9日（超额配售部分）
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,107,160.20
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	28,818.50
二、募集资金净额	1,078,341.70
减：	
以前年度已使用金额	914,306.59
本年度使用金额	117,868.42
暂时补流金额	0
现金管理金额	57,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.54
加：	
募集资金利息收入	12,043.43
三、报告期期末募集资金余额	709.58

注：公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用，合计270.85万元，公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。具体内容详见2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年6月公司就含首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金（针对超额配售）专户存储三方监管协议》，同月公司与子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联先锋”）、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月，因募投项目“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”结项，将此前开立的募集资金账户注销，并于同月与芯联先锋、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
芯联集成	招商银行股份有限公司绍兴分行	575903998610666	-	已注销
芯联集成	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000309403	-	已注销
芯联集成	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100158340	-	已注销
芯联集成	兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100165889	-	已注销
芯联先锋	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100159778	-	已注销
芯联先锋	招商银行股份有限公司绍兴分行	575904790310018	42.11	使用中
芯联先锋	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000368118	461.71	使用中
芯联先锋	中信银行股份有限公司绍兴分行	8110801012802844254	205.76	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理申请核销表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）	2024年10月25日	2025年10月24日	2024年10月25日
68,300.00	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）	2025年10月24日	2026年10月23日	2025年10月24日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
芯联先锋	交通银行股份有限公司绍兴分行	结构存款	保本浮动收益型	22,000.00	2025-11-3	2026-1-28	-	22,000.00	0.9%/1.65%/1.85%	-
芯联先锋	中信银行股份有限公司绍兴分行	结构存款	保本浮动收益型	5,500.00	2025-11-8	2026-2-6	-	5,500.00	1%-1.71%	-
芯联先锋	中信银行股份有限公司绍兴分行	结构存款	保本浮动收益型	30,000.00	2025-11-26	2026-2-28	-	30,000.00	1%-1.71%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内募集资金投资项目不存在变更情况。公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》。此议案已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意调减“二期晶圆制造项目”拟使用募集资金投资的金额27.90亿元，并将该等调减金额通过向公司控股子公司芯联先锋增资的方式用于新增募投项目“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”。公司将充分有效发挥募集资金作用，满足12英寸硅基芯片的生产需求，进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，实现国内12英寸车载功率半导体芯片的工艺自主化和大规模制造产业化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

芯联集成《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了芯联集成2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

本年度投入募集资金总额	117,868.42
已累计投入募集资金总额	1,025,006.85
变更用途的募集资金总额	500,000.00
变更用途的募集资金总额比例	46.37%

承诺投资项目	募投项目性质	投目已更部变（有）	变项含分更如有）	资诺总集资额	后拟募金更人资额	期诺金截至承入额(1)	本度入额	年投金累计入额(2)	截至末投额诺金差(3)=(2)-(1)	期计金承入的额=截末投进(%)=(4)=(2)/(1)	达预使状日（到月份）	项目可行性是否发生重大变化	本年度实现的效益	是否达到预计效益	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	目行是发重变化
二期晶圆制造项目	生产建设	是		666,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	100.00	2023年6月30日	不适用		不适用			否
中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	生产建设	是		0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	100.00	2023年9月30日	不适用		不适用			否
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	生产建设	是		0.00	279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	-53,334.85	80.88	2027年12月31日	不适用		不适用			否
补充流动资金	补流	无		412,341.70	412,341.70	412,341.70	0.00	412,341.70	0.00	100.00	不适用	不适用		不适用			否
合计				1,078,341.70	1,078,341.70	1,078,341.70	117,868.42	1,025,006.85	-53,334.85	—	—			—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用																
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。																
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。																
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。																
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。																
募集资金结余的金额及形成原因	不适用																
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。																

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	期诺投额(1)	截至计金额	本年度实现的效益	本度入额	实际投入金额(2)	资进(%)=(2)/(1)	项目预定可使状日（到月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	二期晶圆制造项目	生产建设	芯联先锋	浙江绍兴	279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	225,665.15	80.88	2027年12月31日	不适用	不适用	否	2024年4月9日	2024年4月26日
合计					279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	-	-			-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，新增募投项目“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”来满足12英寸硅基芯片的生产需求。公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（2024-001）。此事项已经2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，决议内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-007）。															
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用															

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-013

芯联集成电路制造股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计61.80万股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年4月13日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2024年4月15日至2024年4月24日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030）。

（四）2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-035）。

（五）2024年6月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2025年5月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，并对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（八）2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，并对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》《考核管理办法》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：

鉴于公司《激励计划》预留授予的激励对象中23人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计61.80万股限制性股票不得归属并按作废处理。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次作废限制性股票的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-014

芯联集成电路制造股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次第二类限制性股票拟归属数量：1,114.90万股

● 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2023年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

1、预留授予日：2025年4月22日。

2、预留授予数量：2,291.60万股，占目前公司股本总额的0.27%。

3、预留授予人数：354人。

4、预留授予价格：2.56元/股。

5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日且不得在下列期间内：

① 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③ 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

④ 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分在2024年三季报披露前授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工（共计763人）			9,166.40	80%	1.30%
预留部分			2,291.60	20%	0.33%
合计			11,458.00	100%	1.63%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

5、自2026年4月17日起单体中先生不再纳入核心技术人员认定范围。

（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月15日至2024年4月24日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030）。

3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-035）。

4、2024年6月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年5月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（三）限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2024年6月4日	2.56元/股	9,166.40万股	763	2,291.60万股
预留授予	2025年4月22日	2.56元/股	2,291.60万股	354	0

（四）本激励计划的归属情况

归属期次	归属日期	授予价格	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量
首次授予第一个归属期	2025年6月4日	2.56元/股	3,661.76万股	760人	7,784.24万股

二、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

（一）本激励计划预留授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。预留授予日为2025年4月22日，本激励计划中预留授予的限制性股票于2026年4月22日进入第一个归属期。

（二）关于本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年年度股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
1、公司未